9 : 0" #$ + (*& ' ! + " - #$ + I$
+ ! & * 9 : . 6$" ' & >000 >+ C

9 : ' 5 5 * '" 5 (" ('&&2 '" *(' +J *+
#$"&$! ! ! " &9G 1 '* $'" &$- ' ! I -&+& 7
C

9 : < I '*$ 5 H < ; %& #&"! $) *&#$&'#' " ! (
* " +*$ +'&& ," &9G (*& I ' +J' ' ! 1 ' # +* $
+ " - I '$ 3 !2 + ! I ' +J >000 $ &+* &
C

9 : 王国忠 51 焊点三维形态预测及其对焊点可靠性的影响 9% 哈尔滨 哈尔滨工业大学工学 7

9 7: 朱奇农 王国忠 等 倒装焊中复合 5 I, 焊点形态模拟9G 电子学报 7C

9 : 3$JJ H 5 $# + 02 '2 $1 ' '" ? $& 903A6<: **(AA
. . . && ! A# +&' #A, A, $ JJ A 2 "2 $

T € e º

f ¯ 男 年生 哈尔滨工业大学焊接系博士研究生 研究方向为光电子封装光纤无源对准方法研究 发表论文 篇 0 ' " 4 '+ K * ! +

¦ =] 年生 哈尔滨工业大学教授、工学博士、博士研究生导师 自 7年起在微连接和微电子封装方面做了大量系统研究 发表论文 篇 获省部级科技进步奖 7 项 获国家发明专利 项

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net